

(11) Publication number:

(71) Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD

04108848 A

Generated Document.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 02226673

(51) Intl. Cl.: C08L 59/04

(22) Application date: 30.08.90

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

09.04.92

(84) Designated contracting states: (74) Representative:

(72) Inventor: OKA MIKIO

(54) LOW-SECONDARY **SHRINKABLE POLYOXYMETHYLENE** COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a composition, improved in secondary shrinkability without impairing mechanical strength, rigidity, etc., and suitable as panels, etc., in keyboards of personal computers, etc., by blending polyoxymethylene polymer with a polyoxymethylene random copolymer in a specific proportion.

CONSTITUTION: A composition is obtained by blending (A) 5-40wt.% polyoxymethylene homopolymer, prepared by polymerizing formaldehyde or a cyclic oligomer such as trimer or tetramer, substantially composed of oxymethylene units and having 10000-200000 number-average molecular weight and 0.1-70g/10min melt index and 172-175° C melting point with (B) 95-60wt.% polyoxymethylene random copolymer having a structure in which oxyalkylene units are randomly introduced into a chain composed of the oxymethylene units, 10000-200000 number-average molecular weight, 0.1-60g/10min melt index and 160-165° C melting point.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

# ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ② 公開特許公報(A) 平4-108848

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

⑧公開 平成4年(1992)4月9日

C 08 L 59/04

LMP

8215-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

60発明の名称

低二次収縮性ポリオキシメチレン組成物

②特 願 平2-226673

**20出 願 平2(1990)8月30日** 

@発明者

美喜夫

岡山県倉敷市潮通3丁目13番1 旭化成工業株式会社内

 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

個代 理 人 弁理士 阿 形 明 外1名

#### 明 細 審

1. 発明の名称 低二次収縮性ポリオキシメチレン 組成物

#### 2. 特許請求の範囲

1 (A)ポリオキシメチレンホモポリマー5~4 重量%と(B)ポリオキシメチレンランダムコポリマー95~60重量%とから成る低二次収縮性ポリオキシメチレン組成物。

# 3. 発明の詳細な説明

# 産業上の利用分野

本発明は新規な低二次収縮性ポリオキシメチレン組成物、さらに詳しくは、成形後の長時間放置や高温雰囲気下における収縮率が極めて低く、寸法安定性が要求される精密部品用の成形材料などとして好適なポリオキシメチレン組成物に関するものである。

#### 従来の技術

従来、ポリオキシメチレンは機械強度が高く、 かつ剛性、耐クリープ特性、耐溶剤性、指動性な どに優れていることから、例えば自動車、電気製品、機械などの機構部品をはじめ、多くの成形品 の材料として幅広く用いられている。

しかしながら、このポリオキシメチレンは結晶 性衝脂であるため、成形後に長時間放置したり、 高温雰囲気下にさらすとあと収縮、すなわち二次 収縮による寸法変化が生じることから、精密部品 への応用が制限されるのを免れないという欠点を 有している。

このポリオキシメチレンの二次収縮性を改良する方法として、従来無機フィラーを配合する方法が知られている。しかしながら、無機フィラーを配合したポリオキシメチレン組成物は、機械的特性、特に、伸展や耐衝撃性に劣るとともに、成形性が悪い上、ウエルド部の強度も低く、精密部品の材料として使用しにくいという欠点がある。

他方、異種のポリオキシメチレン同士からなる 組成物、例えばポリオキシメチレンホモポリマー 70~99.1重%とポリオキシメチレンコポリマー30 ~0.1重量%とから成る高強度、高弾性率の球晶 サイズ5 μα以下のポリアセタール固密体や(特別 昭64-20258号公報)、それぞれのメルトインデッ クス比が15以上の分子量の異なる2成分のポリ オキシメチレン重合体を混合して流動性を改善し たポリアセタール樹脂組成物(特公昭55-39182号 公報)も投案されている。

しかしながら、これらの組成物は低二次収縮性の改良とは全く関係がなく、組成自体も全く異なるものである。

### 発明が解決しようとする課題

本発明は、ポリオキシメチレンが本来有する特性を保持するとともに、成形後の長時間放置や高温雰囲気下における収縮率が極めて低く、寸法安定性が要求される精密部品用の成形材料などとして好適な低二次収縮性ポリオキシメチレン組成物を提供することを目的としてなされたものである。課題を解決するための手段

本発明者は低二次収縮性、すなわちあと収縮を 生じないポリオキシメチレン組成物について鋭意 研究を重ねた結果、ポリオキシメチレンホモポリ

-3-

ンランダムコポリマーは、オキシメチレン単位か らなる連鎖中にオキシアルキレン単位がランダム に導入された構造を有する重合体であって、一般 に数オキシメチレン単位はホルムアルデヒド又は トリオキサンやテトラオキサンなどのホルムアル デヒドの環状オリゴマーから誘導され、一方、オ キシアルキレン単位は、エチレンオキシド、プロ ピレンオキシド、エピクロロヒドリン、1.3・ジオ キソラン、グリコールのホルマール、ジグリコー ルのホルマールなどの環状エーテルから誘導され る。

該オキシメチレンコポリマーの代褒例としては、トリオキサンとエチレンオキシドとの共重合体、ホルムアルデヒドとプロピレンオキシドとの共重合体、トリオキサンと1.3・ジオキソランとの共重合体などが挙げられ、その数平均分子量が10.000~200.000、好ましくは20.000~100.000の範囲にあり、かつN1値が0.1~60g/10分で、融点が160~165℃、好ましくは160~162℃の範囲にあるものが好適である。

マーとポリオキシメチレンランダムコポリマーと を、所定の割合でプレンドすることにより、その 目的を達成しうることを見い出し、この知見に基 づいて本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、(A)ポリオキシメチレンホモボリマー5~40重量%と(B)ポリオキシメチレンランダムコポリマー95~60重量%とから成る低二次収縮性ポリオキシメチレシ組成物を提供するものである。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明組成物において、(A)成分として用いられるポリオキシメチレンホモポリマーは、ホルムアルデヒド又はその三量体(トリオキサン)や四量体(テトラオキサン)などの環状オリゴマーを重合して得られる実質上オキシメチレン単位から成るものであって、数平均分子量が10,000~200,000、好ましくは20,000~100,000の範囲にあり、かつメルトインデックス(MI)値が0.1~70g/10分で、融点が172~175℃の範囲にあるものが好適である。

一方、(B)成分として用いられるオキシメチレ

-4-

また、前記のポリオキシメチレンランダムコポリマーとポリオキシメチレンホモポリマーは、それぞれのNI値(ASTN D1238-57T E条件、190℃、荷重2-16kg)の比が12以下、好ましくは10以下、より好ましくは5以下になるような組み合わせが、二次収縮性の点から望ましい。このNI値の比が12を超えると、二次収縮性の改良効果が十分に発揮されなくなる傾向がみられる。

本発明組成物における前記(A)成分のポリオキシメチレンホモポリマーと(B)成分のポリオキシメチレンランダムコポリマーとの配合割合については、数(A)成分と(B)成分との合計重量に基づき、(A)成分が5~40重量%及び(B)成分が95~60重量%の範囲にあることが必要である。この配合割合が前記範囲を逸脱すると二次収縮性の改良効果が十分に発揮されず、本発明の目的が達せられない。

本発明組成物の調製方法については特に制限はなく、例えば通常の押出し機を用いてペレット同士を混錬してもよいし、ペレット化前の重合パウ



その用途に応じ

ダー状態で混練してもよく、その用途に応じて適 当な方法を選択すればよい。

また、前記観製の際に、本発明の目的をそこな わない範囲で、所望に応じ各種派加成分、例えば、 熱安定剤、酸化防止剤、帯電防止剤、離燃剤、可 塑剤、離型剤、着色剤、潤滑剤、あるいは炭素繊 継、ガラス繊維、セラミックなどの充てん剤など を抵加することができる。

#### 発明の効果

本発明のポリオキシメチレン組成物は、ポリオキシメチレンホモポリマーとポリオキシメチレン ランダムコポリマーとを特定の割合でプレンドすることにより、ポリオキシメチレンが本来有する 被被的強度、剛性、耐衝撃性などをそこなが後の あと収縮性、すなわち二次収縮性を改良したもの であって、例えばパソコンやワープロなどの ポードのパネル、カセットテープやVTRなどの アウトサート成形品、精密複器などに用いられる ギャー類のインサート成形品などの成形材料とし

-7-

NI値の異なる各種の末端がアセチル化されたポリオキシメチレンホモポリマーと、トリオキサンとエチレンオキシドとから得られたNI値の異なる各種のポリオキシメチレンランダムコポリマーとを、表に示す割合で、200℃に設定したノーベントタイプの30mm押出し機を用いて混練し、ペレット化した。

次いで、このペレットを80℃で14時間乾燥 させたのち成形し、あと収縮率を求めた。その結 果を表に示す。 て好適に用いられる。なかでも厚さ 2 mm以下の成形体、特にキーボードパネルに適している。

#### 实施例

次に、実施例により本発明をさらに詳細に説明 するが、本発明はこれらの例によってなんら限定 されるものではない。

なお、各物性は次に示す方法に従って求めた。 (1)あと収縮性(二次収縮性)

成形後、23℃で48時間放置した際の流動方向の寸法をD<sub>1</sub>(nn)とし、成形後、23℃で48時間放置したのち、80℃で6時間加熱し、その後23℃で48時間放置した際の流動方向の寸法をD<sub>1</sub>(nn)として、次式に従いあと収縮率(%)を求めた。

ただし、金型寸法 6 6 mm、厚み 1 mm (2)ポリオキシメチレンのNI値 ASTN D1238-57T E条件に準拠し、温度190℃、 荷重2.16kgの条件で求めた。 実施例 1 ~ 8 、比較例 1 ~ 7

-8-

計画	あと収縮率		8	91.0	0.15	0.15	0.17	0.18	0.16	0.28	0.27	0.29	83.0	0.30	83.0	0.28	0.28	0.30
	JM(B)	\	(S)NI	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.22	0.07	0.03	<u>0:</u>	1.0	0.1	1.0	0.1	1	ŀ
4	ポリマー	*	(%1%)	95	06	8	60	08	08	8	8	22	52	01	2	_	001	ι
ン類成	・レンランガムコ	致	MP(v)	161.5	. 191	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	ı
1 # x	(B)ポリオキシメチレンランダムコポリマー	舞	M I (4/1049)	9.0	9.0	9.0	9.0	3.0	10	3.0	0.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	1
*	ポリマー	#	(%14)	5	10	02	40	20	20	20	20	20	75	06	92	88	1	100
ı) #	メチレンホモ	籔	MP("C)	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	1	174
*	(A)ポリオキシメチレンホモポリマー	點	K#01/9) 1 W	0.6	0.6	0.6	9.0	30	45	. 42	3.0	9.0	9.0	9.0	0.6	0.6	1	9.0
	_			天	2	က	田 4	5	9	7	8	_	표 2	3	4	5	<b>S</b>	7



## 手統 補正書

平成2年10月 28 日

特許庁長官 植 松 敏 製

1. 事件の表示

平成 2 年特 許 顯第226673号

2. 発明の名称

低二次収縮性ポリオキシメチレン組成物

3.補正をする者

事件との関係 特許出願人

大阪府大阪市北区堂島浜 1 丁目 2 番 6 号 (003) 旭 化 成 工 菜 株 式 会 社 代表者 号 倉 礼 一

4.代理人

東京都港区新橋2丁目2番2号川志満・邦信ビル8階 (7182)弁理士 阿 形 明/京記 電話(591)9910番 会報子

- 5. 補正命令の日付 自 発
- 6. 補正により増加する請求項の数 0
- 7. 補正の対象 明細書の特許請求の範囲の欄

及び発明の詳細な説明の概 特許庁

光 新 群

8. 補正の内容

- (1) 特許請求の範囲を別紙のとおり訂正します。
- (2) 明細書第8ページ末行の「実施例1~8、 比較例1~7」を「実施例1~6、比較例1~9」 に訂正します。
- (3) 同第10ページの設を別紙のとおり訂正します。

宦	と収縮率		(%)	0.16	0.15	0.15	0.17	0.18	0.16	0.29	0.29	0.30	0.29	0.29	0.28	0.30	0.24	
25.	46				_		Ĺ											ľ
政	南メルトインデックス		低メルトインデックス	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1		0.07	0 00
	ゲムコポリマー	**	(wt%)	95	06	80	09	. 08	80	90	25	10	S		100		80	Võ
4	メチレンラン	凝	MP (°C)	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	161.5	ı	161.5	7 191
*	(B)ポリオキシ	鋤	M I (8/10A)	9.0	0.6	9.0	9.0	3.0	10	9.0	0.6	9.6	9.0	9.0	0.6	1	3.0	-
#	ተ ጋ ር ዝ	Ħ	(%1%)	5	10	20	40	20	02	20	75	06	98	66	1	100	20	06
y A	メチレンホモポ	類	MP (°C)	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	_	174	174	174
ኊ	(A)ポリオキシ	静	M I (\$/10#)	9.6	9.0	9.0	9.0	30	45	9.6	9.0	9.0	9.0	9.0		9.0	45	3.0
				1	2	3	4	2	9	1	2	3	4	S.	9	7	∞	6
				鉃		摇		鰘			丑			*	室			



1 (A)ポリオキシメチレンホモポリマー 5~40 重量%と(B)ポリオキシメチレンランダムコポリマー 95~60重量%とから成る低二次収縮性ポリオキシメチレン組成物。